

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】令和2年12月24日(2020.12.24)

【公開番号】特開2019-171344(P2019-171344A)

【公開日】令和1年10月10日(2019.10.10)

【年通号数】公開・登録公報2019-041

【出願番号】特願2018-65700(P2018-65700)

【国際特許分類】

B 0 1 J	35/04	(2006.01)
B 0 1 J	35/02	(2006.01)
F 0 1 N	3/20	(2006.01)
F 0 1 N	3/28	(2006.01)
C 0 4 B	41/88	(2006.01)
B 0 1 D	53/94	(2006.01)
H 0 5 B	3/03	(2006.01)
H 0 5 B	3/10	(2006.01)

【F I】

B 0 1 J	35/04	3 0 1 F
B 0 1 J	35/02	Z A B G
F 0 1 N	3/20	K
F 0 1 N	3/28	3 0 1 P
C 0 4 B	41/88	S
B 0 1 D	53/94	2 2 2
B 0 1 D	53/94	2 4 5
B 0 1 D	53/94	2 8 0
H 0 5 B	3/03	
H 0 5 B	3/10	A

【手続補正書】

【提出日】令和2年11月12日(2020.11.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 9 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 9 0】

(5. 電極層形成ペーストの塗布)

電極層形成ペーストとして市販の銀ペーストを上記焼成ハニカム構造部の外周側壁の外面上に中心軸を挟んで対向するように、且つ、各塗布部の周方向中心に各端子接続部が位置するように均一な厚みとなるように二箇所塗布した(図3のθ = 0°とした。)。この際、円柱状の各端子接続部の側面を銀ペーストで被覆した。また、各塗布部は、一方の底面から他方の底面に近づくにつれて周方向の幅が狭くなるように(セルの流路方向に垂直な断面において中心角θが次第に小さくなるように)して、帯状に形成した。次いで、銀ペーストを塗布後の焼成ハニカム構造部を120℃で乾燥して、製品であるハニカム構造体を得た。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 9 8

【補正方法】変更

【補正の内容】**【0098】**

<比較例1、実施例2～7>

実施例1と同様の手順で端子接続部付き焼成ハニカム構造部を作製した。その後、試験番号に応じて表1の記載の電極層条件に変更した他は、実施例1と同様の手順でハニカム構造体を製造した。表1中、「デザイン種別」は図4に示す(a)～(d)のどの電極層デザインに対応するかを示す。表1中、「セルの流路方向における一端の位置」及び「セルの流路方向における他端の位置」はセルの流路の全長(100%)に対する、一方の底面からの電極層の一端及び他端の相対的位置を指す。端子接続部の位置についても同様に、同一の端部からの相対位置(%)を示す。